（上接D23版）

1）重庆西南集成电路设计有限责任公司-高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目

募投项目建设情况

项目建设周期	预计完成时间	募投项目总额（万元）	截至2026年6月累计投入金额（万元）	资金使用率	形成资产（不含税/万元）
5年	2026年12月	41,006.38 [注1]	27,183.78	66.29%	8,135.38[注2]

[注1] 该项目投资总额41,006.38万元，包含募集资金投资金额33,656.38万元，自有资金投资额7,350.00万元。

[注2] 募投项目形成资产金额为8,135.38万元，其中募集资金置换形成资产金额为383.18万元，募集资金采购形成资产金额为7,752.19万元。

②主要采购内容及后续计划

截至2026年6月，募投项目累计投入明细：

单位：万元

序号	项目类别	投资总额	投入金额	剩余	资金使用率
1	房屋租赁投资	1,163.50	180.02	983.48	15.47%
2	软硬件设备购置及安装投资	20,642.60	10,036.09	10,606.51	48.62%
3	研发人员投资	11,231.00	9,773.33	1,457.67	87.02%
4	其它研发费用投资	7,350.00	7,194.34	155.66	97.88%
5	项目预备费投资	619.28	-	619.28	0.00%
合计		41,006.38	27,183.78	13,822.60	66.29%

截至2026年6月，主要资产采购明细：

采购方名称[注]	关联关系	采购内容	采购金额（万元）
供应商十五	非关联方	数模混合EDA设计软件	4,300.00
北京华大九天科技股份有限公司	非关联方	混合信号集成电路EDA设计软件	1,446.00
供应商十七	非关联方	PXIe射频前端ATE	1,350.00
芯和半导体科技（上海）股份有限公司	非关联方	射频微波电路与通信系统仿真软件	560.00
供应商十六	非关联方	无线测试系统	438.64
成都方昇科技有限公司	非关联方	数模混合ATE测试仪	229.80
西安蓝士半导体科技有限公司	非关联方	数字ATE测试仪	104.00

[注] 主要列举采购金额100万以上资产。

后续计划于2026年12月前完成11,881.63万元测试仪器设备、试验设备、模组设计软件等投资，其中已有6,570.13万元的投资项目已完成招标并签订合同。

③项目进度缓慢的主要原因

一是西南设计在2025年3月被列入实体管控清单，原计划购置的相关进口仪器设备需要重新调研、调整；二是西南设计当前的科研生产场地已超负荷使用，部分大型设备购置后无场地使用，根据公司统筹规划计划2026年12月完成新场地的搬迁。为此，该项目可行性未发生变化，按计划结合公司业务发展规划、主营产品应用领域开展项目建设，与前期信息披露一致。

④项目合理性分析

无线及新能源项目募集资金33,656.38万元，建设周期为5年，预计于2026年12月完成。公司将实时跟踪募投项目实施进展，必要时提交相应决策机构对募投项目实施计划进行调整。

募集资金按照计划分别投资厂房屋租赁投资、软硬件设备购置及安装投资、研发人员投资、其它研发费用投资等方面，截至2026年5月已投入19,637.84万元使用率58.35%，后续将完成测试仪器设备、试验设备、模组设计软件等1,1881.63万元投资，研发人员投资1,200.00万元，其它研发费用投资155.00万元，项目达到可使用状态时募集资金预计使用32,874.47万元，使用率97.68%。因此，募集资金按计划投入项目建设，不存在资金使用去向不明的情形。

2）深圳市瑞晶实业有限公司—智能电源集成电路应用产业园建设项目

①募投项目建设情况

项目建设周期	预计完成时间	募投项目总额（万元）	截至2026年6月累计投入金额（万元）	资金使用率	形成资产（不含税/万元）
5年（含延期）	2026年12月	32,434.00 [注]	21,511.73	66.32%	20,110.71

[注] 该项目投资总额32,434.00万元，包含募集资金投资金额31,837.00万元，自有资金投资额597.00万元。

②主要采购内容及后续计划

截至2026年6月，募投项目累计投入明细：

序号	项目类别	投资总额	投入金额	剩余	资金使用率
1	场地购置及装修费用	24,115.90	21,511.73	2,604.17	89.20%
2	工程建设其他费用	248.80	-	248.80	-
3	预备费用	98.30	-	98.30	-
4	铺底流动资金	1,800.00	-	1,800.00	-
5	采购设备	6,171.00	-	6,171.00	-
合计		32,434.00	21,511.73	10,922.27	66.32%

单位：万元

截至2026年6月，主要资产采购明细：

主要资产采购方名称	关联关系	采购内容	采购时间	采购金额（万元）
深圳市龙岗区土建工产业空间发展有限公司	非关联方	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路16号宝龙专精特新产业园3栋104、204、304、404、504五层厂房19,203.29平方米和4栋A座301-324、401-424、501-524、601-624四层96间宿舍4,038.48平方米	厂房采购时间：2023年12月18日；宿舍采购时间：2024年12月25日	21,502.15

后续计划于2026年12月前完成10,008.01万元厂房及配套用房装饰装修、工艺设备等方面的投资，目前正在进行招投标相关工作。

③项目进度缓慢的主要原因

一是募投项目实施地点及投资总额变更：由原广东省东莞市常平镇环常南路9号时代智汇工业园（生产基地）、深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路交汇处启迪协信科技园（研发中心）变更为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园，投资总额由32,792.11万元变更为32,434.00万元，因原公告场地包含生产场所及研发中心，变更后为生产场所和宿舍楼，所以购置费及装修费也有所调整；

二是厂房正式验收延迟，部分楼层的电力供应能力不满足公司最新的生产需求，需做相应调整改造并扩容增加572 KVA的电量，实际验收时间为2025年4月；

三是现有及新客户高精度生产工艺要求对原有生产布局、设备选型及铺设提出了更高的要求，加上上市公司的整体战略发展规划，在原有的设计上做了较大幅度优化修改，重新绘制装修平面图并核算评估结构荷载及其功能性。同时新方案尚需经过生产、工程、安全多部门联合评审，厂房及配套用房改造、装修的公开招标工作所需周期较长，并涉及后续生产线搬迁、设备安装调试等工作，因此建设周期较长。

在保持募投项目的实施主体、募集资金投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，统筹规划计划2026年12月完成新场地的搬迁。为此，该项目可行性未发生变化，按计划结合公司业务发展规划、主营产品应用领域开展项目建设，与前期信息披露一致。

④项目合理性分析

电源项目募集资金31,837.00万元，建设周期为5年（含延期），预计于2026年12月完成。公司将实时跟踪募投项目实施进展，必要时提交相应决策机构对募投项目实施计划进行调整。

募集资金按照计划分别投资厂房及配套用房投资、装饰装修投资、工艺设备投资等方面，截至2026年5月已投入21,502.01万元使用率67.54%。后续将完成厂房及配套用房装修3,734.96万元、工艺设备6,273.05万元投资，项目达到可使用状态时募集资金预计使用31,510.02万元，使用率98.86%，因此，募集资金按计划投入项目建设，不存在资金使用去向不明的情形。

3）重庆中科芯亿达电子有限公司-高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目

①募投项目建设情况

项目建设周期	完成时间	募投项目总额（万元）	截止2026年6月累计投入金额（万元）	资金使用率	形成资产（不含税/万元）
4.5年（含延期）	2026年6月	12,187.80 [注]	9,708.82	79.66%	1,889.18

[注] 该项目投资总额12,187.80万元，包含募集资金投资金额12,084.79万元，自有资金投资额103.02万元。

②主要采购内容及结项情况

截止2026年6月，募投项目累计投入明细：

单位：万元

序号	项目类别	投资总额	投入金额	结余	资金使用率	备注
1	场地租赁投资	103.02	3.87	99.15	3.76%	自有资金
2	软硬件设备购置及安装投资	2,262.90	2,149.77	113.13	95.00%	软硬件设备投资2,134.77万元，预备费15万元
3	研发人员工资投资	3,004.00	3,004.00	-	100.00%	
4	其它研发费用投资	3,300.00	1,100.29	2,199.71	33.34%	用于流片、制版、封装测试等
5	项目预备费投资	67.89	3.52	64.37	5.18%	
6	铺底流动资金	3,450.00	3,447.37	2.63	99.92%	用于流片、封测加工
合计		12,187.80	9,708.82	2,478.99	79.66%	

[注] 各项投资金额加总与投资总额合计存在尾差，系数值四舍五入所致。

截止2026年6月，主要资产采购明细：

采购方名称	关联关系	采购内容	采购金额（万元）
供应商十五	非关联方	EDA设计软件	1,200.00
中国远东国际招标有限公司	关联方	服务器	163.80
深圳市纳科电子有限公司	非关联方	超声波扫描显微镜	145.00
成都思壮科技有限公司	非关联方	示波器、函数发生器、电流探头及放大器	141.62
深圳市赛时宇科技有限公司	非关联方	集成电路测试系统	118.50
重庆为众科技有限公司	非关联方	存储阵列	92.70
深圳市晖诚科技有限公司	非关联方	X-ray透视仪	56.90
伟思富奇环境试验仪器（太仓）有限公司	非关联方	高低温冲击箱	54.70
成都福沫科技有限公司	非关联方	蓝牙分析仪	43.70
供应商十七	非关联方	频谱分析仪	34.20
成都思维嘉科技有限公司	非关联方	高低温冲击箱	27.00
佛山市联动科技股份有限公司	非关联方	雪崩测试仪	19.80
重庆烁凡科技有限公司	非关联方	设计工作站	13.75
四川时宇兴科技有限公司	非关联方	数字万用表	10.50
北京神州技测科技有限公司	非关联方	多通道可编程电源、电源	9.70
重庆硕成科技有限公司	非关联方	设计工作站	2.90
合计			2,134.77

通过该项目，芯亿达建成研发仿真平台、可靠性测试中心、完善芯片设计、验证、封装测试全流程配套条件；累计完成产品迭代升级、新产品研发50余款，四款核心产品通过AEC-Q100车规认证，产品高端市场准入能力显著增强。累计申请国家发明、实用新型等专利52项，培养芯片设计、工艺验证、应用开发专业技术人才33名。项目已经达到可使用状态。

芯亿达项目募集资金12,084.79万元，建设周期为4.5年（含延期）于2026年6月完成。募集资金按照计划分别投资于软硬件设备购置及安装投资、研发人员工资投资、其它研发费用投资、项目预备费投资、铺底流动资金。项目达到可使用状态时募集资金使用9,704.95万元，募集资金使用率80.31%，剩余的2,393.21万元（含累计利息收入扣除手续费后净额13.37万元，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）将申请为补充流动资金，因此，不存在资金使用去向不明的情形。

（3）研发投入资本化的具体时点、判断依据及合理性，是否符合企业会计准则规定；结合无形资产的具体构成、相关专利技术在产品中的应用情况、对应产品的销售及利润情况，说明无形资产、开发支出的减值计提是否及时、充分。

1）研发投入资本化的具体时点、判断依据及合理性，是否符合企业会计准则规定

根据《企业会计准则第6号——无形资产》规定，公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足资本化条件的，确认为无形资产，不能满足资本化条件的开发阶段的支出计入当期损益。

公司研发支出资本化的开始时点：经公司研发部门等部门从研发项目产品的市场价值及其技术可行性进行调研后进行综合评估该项目是否具备进入开发阶段要求，若该项目满足开发阶段要求，则由各部门评审通过项目资本化项目任务书，评审部门包含市场部、设计部、测试部、生产运营部、质量部、财务部、相关分管领导，评审内容包含技术可行性、未来产生效益等。

公司资本化结束时点：以研发成果达到预定可使用状态即满足量产阶段技术要求作为资本化处理的结束时点，研发项目完成后，公司组织验收评审对研发项目进行验收，并形成无形资产验收表（通常由公司开发部、市场部、质量部、财务部共同确认），通过验收即停止研发支出资本化，以无形资产验收表作为研发支出资本化的结束时点。研发投入相关资本化依据充分、合理，符合企业会计准则相关规定。

2）结合无形资产的具体构成、相关专利技术在产品中的应用情况、对应产品的销售及利润情况，说明无形资产、开发支出的减值计提是否及时、充分

①无形资产的具体构成

截至2025年12月31日，公司无形资产账面价值7,209.90万元，具体构成如下：

单位：万元

项 目	专利权	软件	合 计
账面原值	13,521.31	3,923.19	17,444.50
累计摊销	8,968.47	795.85	9,764.32
减值准备	470.28	0.00	470.28
账面价值	4,082.56	3,127.34	7,209.90

软件主要系公司购买的混合信号集成电路EDA设计软件、数模混合EDA设计软件、射频微波电路与通信系统仿真软件、射频IC设计与验证电磁场仿真软件等；专利权系公司自行研发取得的专利技术。

②相关专利技术在产品中的应用情况、对应产品的销售及利润情况，说明无形资产、开发支出的减值计提是否及时、充分

公司专利技术主要运用于安全电子、卫星通信与导航、蜂窝与短距通信、能源管理、工业/汽车及消费电子、智能电源等细分领域，具体专利技术对应的产品系列及对应产品2025年度的销售及毛利情况如下：

单位：万元

无形资产名称	资产原值[注1]	资产净值	专利形成时间	产品系列	2025年销售金额	2025年销售毛利
一种兼容语音通道的宽带接收机	1,616.84	943.15	2023年12月	XND2260系列	1,384.15	1,206.15
射频放大器及其控制方法、射频芯片、卫星通信接收机[注2]	799.34	772.70	2025年11月	XND2336MM	82.97	71.84
一种数控移相衰减器温度补偿方法	685.17	65.40	2023年3月	X130系列	514.66	461.13
幅相控制电路的幅相二维优化方法、系统、介质及电子设备	681.99	466.03	2024年4月	XND1123系列	406.10	324.03
宽带低谐波倍频电路	665.83	454.98	2024年6月	XND704MD系列	186.06	183.14
限流门限补偿保护电路及参考电流产生装置[注2]	611.78	591.39	2025年11月	XND2152MD系列	1.26	1.08
限流门限补偿保护电路及参考电流产生装置[注2]	492.80	465.42	2025年11月	XNM4650系列、XND4209MD系列	2.58	1.99
汽车锂电池电芯分布式检测系统和方法以及测量模块	339.78	147.24	2023年3月	XND1963系列	9.02	4.41
复用电路和误差放大器以及多路输出低压差线性稳压器	286.73	33.45	2021年8月	XND4103系列	8.28	6.64
用于锁相环的双模式线性化电荷泵电路及模式选择电路	240.48	68.14	2022年6月	XND3151系列	287.47	267.75
一种能检测螺钉松动的UHF RFID标签	202.42	26.99	2021年9月	XNM4644系列	365.82	295.88
一种同步整流二极管及同步整流控制电路	181.56	24.21	2021年9月	XNSSR系列	5.16	0.62
复用电路和误差放大器以及多路输出低压差线性稳压器	113.03	13.19	2021年8月	XND1060系列	43.52	40.67
幅相控制电路的幅相二维优化方法、系统、介质及电子设备	15.03	10.27	2024年4月	XND2310CMO系列	517.19	355.11

[注1]：仅列示截至2025年12月31日尚未摊销完毕的无形资产原值。

[注2]：限流门限补偿保护电路及参考电流产生装置和射频放大器及其控制方法、射频芯片、卫星通信接收机系公司2025年年底资本化形成的无形资产，故2025年收入规模较小。

公司每年末对无形资产-专利权检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定；因公司的专利权运用于产品生产中，未单独出售，故可收回金额按照资产预计未来现金流量的现值确定。

公司在确定资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据该专利权应用产品的预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的预测数据进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债表日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2025年末，公司按照上述资产减值测试方法对无形资产进行减值测试。经测试，公司无形资产的可收回金额均大于或等于无形资产账面价值，2025年度未发生减值，公司无形资产减值计提及时、充分。

3）开发支出的减值计提是否及时、充分

公司2025年12月底在研资本化项目共计7个，具体项目进度如下：

专利名称	期末研发进度	研发项目处于的节点	预计完成时间
直接转换接收机（X805）	70%	优化设计	2026年12月
限流门限补偿保护电路及参考电流产生装置（X908）[注]	80%	优化设计	2026年6月
可极化切换多波束多通道相控阵芯片（XND2319MM）[注]	90%	测试验证	2026年3月
自动频率校正电路及方法（X218）	75%	优化设计	2026年12月
调频连续波调制器（XND2162ANW）	30%	设计开发	2028年12月
面向卫星通信和5G-A及6G通信应用的高性能射频芯片研发及产业化（XNZ1500C）	65%	优化设计	2027年12月
面向北斗三号卫星短消息卫星通信SoC芯片研发与产业化（X801-C-D）	15%	设计开发	2026年12月

注：截止本回复出具之日，可极化切换多波束多通道相控阵芯片（XND2319MM）和限流门限补偿保护电路及参考电流产生装置（X908）项目已结项。

期末开发支出项目进展正常，不存在无法推进或长期挂账的情形，不存在减值迹象。综上，公司无形资产、开发支出的减值计提及时、充分。

【会计师意见】

2025年年审机构-天健会计师事务所（特殊普通合伙）

1.核查程序

1）查阅研发项目立项文件、研发项目资本化任务书等资料，访谈公司研发部门，了解公司各在研项目进展或阶段性成果，了解公司研发项目资本化和费用化公司如何进行划分依据，分析研发投入资本化具体时点判断依据及合理性；

2）获取公司无形资产明细表，分析公司无形资产的具体构成；

3）查阅研发形成的专利情况，以及获取相关专利技术在产品中的应用情况及对应产品销售及利润情况表；

4）了解公司无形资产减值相关计算过程，关注公司在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

5）检查研发形成的专利情况，结合新品销售收入，分析相关专利与收入是否具有相关性及贡献程度。

2.核查结论

经核查，我们认为：

公司研发投入资本化符合企业会计准则规定；2025年度公司无形资产、开发支出未发生减值，前期无形资产、开发支出减值计提及时、充分。

【独立财务顾问意见】

独立财务顾问-中国国际金融股份有限公司

1.核查程序

1）查阅募投项目立项文件；

2）获取公司募投项目采购台账以及建设台账；

3）了解公司电源项目多次延期、无线及新能源项目进度缓慢原因；

4）查阅募投项目前期信息披露文件，并核查信息披露准确性；

5）了解公司电源项目、无线及新能源项目未来投入计划；

6）获取公司功率项目建成验收文件，以及项目产品及专利相关文件。

2.核查结论

经核查，我们认为：

公司募投项目电源项目多次延期、无线及新能源项目进度缓慢均具备合理的商业原因，公司按计划结合业务发展规划、主营产品应用领域开展项目建设，与前期信息披露一致，可行性未发生重大变化，前期信息披露准确；功率项目已经达到可使用状态。

4.年报及前期公告显示，2024年末、2025年末，公司货币资金余额分别为8.23亿元、8.16亿元，其中在关联方财务公司存款余额分别为4.16亿元、6.26亿元；2024年、2025年，公司实现利息收入0.016亿元、0.013亿元，其中在关联方财务公司存款利率为0.10%-0.80%不等。

请公司：（1）区分关联方财务公司、非关联方金融机构货币资金列示货币资金存放的地点及机构名称、金额、存放类型、月均存款余额等，说明利息收入与存款规模的匹配性；（2）对比公司在关联方财务公司、非关联方金融机构的存款利率水平，说明在关联方财务公司存款金额及占比增加的原因及合理性、存款利率水平的公允性，是否在向关联方利益倾斜的情形。请年审会计师发表意见，请独立董事对问题（2）发表意见。

【公司回复】

（1）区分关联方财务公司、非关联方金融机构货币资金列示货币资金存放的地点及机构名称、金额、存放类型、月均存款余额等，说明利息收入与存款规模的匹配性。

关联方财务公司、非关联方金融机构货币资金情况如下：

单位：亿元

存放机构类别	存放类型	2024年12月31日余额	2024年月均存款余额	2024年利息收入	存款利率区间	2025年12月31日余额	2025年月均存款余额	2025年利息收入	存款利率区间
关联方财务公司	活期存款	4.16	3.06	0.016	0.10%-0.80%	6.26	4.50	0.013	0.10%-0.45%
非关联方金融机构（各商业银行）	活期存款	4.07	4.70	0.009	0.10%-0.20%	1.90	3.52	0.003	0.05%-0.10%
合计		8.23	7.76	0.024	/	8.16	8.02	0.016	/

1）存放地点及机构说明

关联方财务公司：存放地点为集团内部财务公司，属于集团下属持牌金融机构，资金统一归集存放于该财务公司账户，为活期存款/七天通知存款；非关联方金融机构：存放于国内各大商业银行，为公司日常经营结算账户，均为银行活期存款。

2）存款类型分析

公司非关联方金融机构存款里2024年12月31日募集资金账户余额4.02亿元，2025年12月31日募集资金余额1.85亿元（剔除1.20亿元的补流款），募集资金系专款专用。公司关联方财务公司存款主要为活期存款/七天通知存款，主要来源为客户回款和汇票到期，回款不固定，同时根据公司业务部门的资金使用计划，每月资金需求较大，对资金需求的流动性和时效性要求较高，不适合存放长期或定期存款。

3）利息收入与存款规模匹配性分析

采用月均存款余额测算年化实际存款利率，验证利息合理性：

①2024年度测算

关联方财务公司：年化实际利率=利息收入÷月均存款余额=0.016亿元（其中7天通知存款0.014亿元）÷3.06亿元≈0.52%，在披露利率区间0.10%-0.80%范围内；非关联方金融机构：年化实际利率=0.009亿元÷4.70亿元≈0.19%，与市场活期存款0.10%-0.20%利率区间一致；关联方财务公司存款年化实际利率高于非关联方金融机构年化实际利率主要系关联方财务公司存在七天通知存款影响，该类存款利率高于活期存款利率，整体具备合理性。

②2025年度测算

关联方财务公司：年化实际利率=0.013亿元（其中7天通知存款0.012亿元）÷4.50亿元≈0.29%，处于披露0.10%-0.45%利率区间内；非关联方金融机构：年化实际利率=0.003亿元÷3.52亿元≈0.085%，落在当期银行活期0.05%-0.10%区间附近。

两年实际测算年化利率均在公司披露的存款利率区间内，利息收入按照各机构月度日均存款规模、协议约定活期利率计息，计息规则符合银行业通用结息方式，利息收入与各期存款月均规模具备合理匹配性；期末时点余额受年末收付款、资金归集时点影响，与月均余额存在差异，属于正常经营下的资金时间分布特征。

（2）对比公司在关联方财务公司、非关联方金融机构的存款利率水平，说明在关联方财务公司存款金额及占比增加的原因及合理性、存款利率水平的公允性，是否存在向关联方利益倾斜的情形。

1）外部商业银行活期存款执行人民银行市场化活期基准利率，利率水平偏低；关联方财务公司作为集团资金集中管理平台，为提升成员单位资金收益，在监管允许范围内设置了更优的活期存款利率区间。

2）关联方财务公司存款金额、存款占比提升的原因及合理性

①国务院国资委的统一制度要求

2022年，国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》第二条提出：推进司库体系不断完善和持续优化，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。核心任务包括：实现集团资金集中管理；，定期将子企业资金归集到集团“资金池”。？

②资金结算安全性、便捷性更高

关联方财务公司为集团持牌金融机构，受金融监管部门监管，资金存放安全性与商业银行一致；同时公司与集团内其他主体往来结算可通过财务公司内部账户划转，结算效率更高，日常经营资金归集存放具备操作合理性。

③期末余额结构变化系资金归集时点安排

2024年末关联方存款占比=4.16÷8.23=50.55%；2025年末关联方存款占比=6.26÷8.16=76.72%，占比提升主要系公司年末回笼资金后，按照集团资金归集规则及时划转至财务公司账户，非单方面向关联方转移资金。

3）存款利率公允性说明

①定价机制公允合规

关联方财务公司存款利率由财务公司依据同期央行基准利率、市场商业银行存款利率水平、集团资金管理政策统一制定，定价流程规范，不存在单独为公司设置特殊利率的情形。

②利率区间具备市场化可比基础

财务公司活期存款利率下限与同期商业银行活期存款利率持平，上限在监管规定的金融机构存款利率浮动范围内，两年实际执行年化利率均落在披露区间内，既未显著偏离市场水平，也未设置异常偏高/偏低的歧视性利率。

4）不存在向关联方利益倾斜的情形

①资金归集基于集团公开管理制度，属于市场化资金集中管理行为，资金存放具备商业合理性；关联方财务公司存款利率整体优于外部商业银行，公司存放资金可以获取更高利息收益，并未让渡自身资金收益给关联方。

②存款协议、利率定价、资金划转均履行内部审批、信息披露程序，资金结算、利息结息公允透明，不存在无偿占用公司资金、异常压低存款利率、违规资金输送等向关联方利益倾斜的情形。

【会计师意见】

2025年年审机构-天健会计师事务所（特殊普通合伙）

1.核查程序

1）了解公司货币资金的存放地点、存放类型、利率水平、发生额、日均存款余额等；

2）查阅公开信息，获取财务公司及商业银行的年度利率水平及LPR变动趋势；

3）查阅公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》，检查是否经相关董事会审议决议；

4）获取已开立银行清单，检查公司账户完整性；

5）结合银行函证程序，检查公司银行存款余额、利息及受限情况等；

6）获取财务公司2025年度财务报表，核查财务公司财务状况、经营成果及现金流量情况以评估是否存在不可控的风险；

7）根据不同类型银行存款平均余额和存款平均利率，复核利息收入发生额是否准确及完整。

2.核查结论

经核查，我们认为：

公司存款利息收入与存款规模具有匹配性；关联方财务公司存款金额及占比增加具有合理性、存款利率水平具有公允性，不存在向关联方利益倾斜的情形。

【独立董事意见】

经核查，公司在关联方财务公司存款利率不低于同期主要商业银行同类存款利率，定价公允；存款金额及占比增加主要系公司经营回款及资金管理需求所致，且公司在财务公司的存款可自由支取，未受任何限制，具有合理性；相关交易遵循市场化原则，不存在向关联方利益倾斜的情形，未损害公司及中小股东利益。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码：688783　　证券简称：西安奕材　　公告编号：2026-025

西安奕斯伟材料科技股份有限公司关于拟引入战略投资方共同对子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：武汉奕斯伟材料科技有限公司（以下简称“武汉奕材”）、武汉奕斯伟硅片技术有限公司（以下简称“武汉硅片”）。

● 投资金额：西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西安奕材”）已对武汉奕材完成5亿元出资，本次拟引入战略投资方共同对武汉奕材新增投资65亿元并由武汉奕材对武汉硅片新增投资65亿元，以推进奕斯伟武汉硅材料基地项目（以下简称“武汉项目”）的建设和投产。武汉奕材新增投资65亿元中，公司拟新增出资10亿元，拟引入战略投资方融资55亿元（含公司及控股子公司核心团队跟投0.8亿元）。本次融资相关协议尚未完成最终签署且资金尚未交割，战略投资方计划投资55亿元与其最终出资的差额，公司后续将通过自有资金出资或引入其他投资方的方式落实，最终确保公司负责落实的70亿元资本金足额到位。

● 本次融资完成后，公司持有武汉奕材的股权比例将由100%降低至约20%-30%之间，其他投资方持股比例预计均低于10%，股权比例较低且分散，结合标的公司股权分布情况、治理结构、实际运营主导权等因素判断，本次融资完成后，公司对武汉奕材及武汉硅片仍保持控制权，武汉奕材及武汉硅片仍属公司合并报表范围内企业。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去12个月内（不含本次），公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚须获得股东会的批准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：鉴于本次融资金额较大，相关投资方尚未完成相关协议的签署，尚未最终确定投资方和投资金额。受投资方的投资意向、融资环境等因素影响，公司能否顺利足额完成融资目标，存在一定不确定性。公司将根据融资进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1.本次交易概况

2025年12月，公司第一届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于审议＜奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议＞的议案》《关于审议对外新设子公司的议案》。具体信息详见公司分别于2025年12月3日、2025年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议的公告》（公告编号：2025-009）、《关于对外新设子公司的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-015）。

随后，公司先行出资5亿元设立武汉奕材，再由武汉奕材设立武汉硅片落地实施武汉项目，武汉项目全面启动。

为确保武汉项目按计划实施，加快武汉项目的建设和投产，落实武汉项目的既定规划及公司长期战略规划，公司计划为武汉项目进行市场化融资，拟与投资方共同对武汉奕材新增投资65亿元，再由武汉奕材向武汉硅片新增投资65亿元，以加快推进武汉项目投产。其中，公司拟新增出资10亿元，各市场化战略投资方合计拟出资55亿元。基于对武汉项目未来发展的信心及投资方增信要求，55亿元融资中，公司及控股子公司的核心团队（以下简称“核心员工跟投平台”）拟跟投0.8亿元（本次投资0.3亿元，后续有权追加投资0.5亿元）。

本次融资战略投资方计划投资55亿元与其最终出资的差额，公司后续将通过自有资金出资或引入投资方的方式落实，最终确保公司负责落实的70亿元资本金足额到位。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（□同比例 ☑非同比例） --增资前标的公司类型：☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	武汉奕斯伟材料科技有限公司、武汉奕斯伟硅片技术有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额：公司对武汉奕材新增出资10亿元，再由武汉奕材对武汉硅片新增出资65亿元 □ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 其他：_引入战略投资方融资___ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

本次交易已经公司第二届董事会第二次会议独立董事专门会议、第二届董事会第二次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》相关规定，本次交易还需提交股东会审议，不需要经过有关部门批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

鉴于公司部分董事和高级管理人员拟通过核心员工跟投平台参与跟投，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组。

（四）至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、核心员工跟投平台

基于对武汉项目未来发展的信心及投资方增信要求，各市场化战略投资方合计出资的55亿元中，公司及控股子公司核心团队（含公司部分董事和高级管理人员）拟通过核心员工跟投平台跟投0.8亿元（本次投资0.3亿元，后续有权追加投资0.5亿元）。截止目前，核心员工跟投平台正在设立中，工商设立登记尚未完成。

（二）其他投资方情况

拟参与武汉项目融资的其他投资方均不属于公司的关联方，包括央企投资平台、地方国资投资平台、产业投资方、银行AIC投资平台等。融资完成后，公司将按照信息披露规则公开披露最终投资方及投资金额情况。

三、投资标的基本情况

武汉奕材为武汉项目融资、控股主体，其全资持有的武汉硅片为武汉项目的实施主体。本次交易，投资方将通过增资武汉奕材再由武汉奕材增资武汉硅片的方式实现对武汉项目的投资。

武汉项目规划产能50万片/月，公司按计划加快推进项目建设工作，截止2026年5月已经实现主厂房封顶，有望于2026年10月提前实现设备搬入，2027年上半年实现首期产能投产。公司当前投建的三座工厂全部满产后，公司总产能将突破180万片/月。

武汉奕材和武汉硅片的基本信息如下：

（一）武汉奕斯伟材料科技有限公司（武汉奕材）

1、武汉奕材基本情况

投资类型	☑增资现有公司（□同比例 ☑非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	武汉奕斯伟材料科技有限公司
统一社会信用代码	☑__91420100MAK2X1B08Q__ □ 不适用
法定代表人	杨新元
成立日期	2025/12/22
注册资本	5亿元人民币
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼763
控股股东/实际控制人	西安奕斯伟材料科技股份有限公司100%持股
主营业务	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料